

Macierz modułów BCM do montażu pionowego ze zintegrowanym radiatorem



Moduł VI Brick BCM Array™ to system dystrybucji energii do montażu pionowego, łączący kompaktowy układ wyprowadzeń i zintegrowany radiator z gęstością mocy wynoszącą do 290 W/cal³. Rozwiązanie to upraszcza odprowadzanie ciepła i ogranicza powierzchnię płytki drukowanej w punkcie obciążenia (POL).

Moduł BCM Array, który cechuje sprawność na poziomie 95% i moc do 600W lub 650W zapewnia nominalne, wejściowe napięcie rzędu 384V i 352V, a wyjściowe na poziomie 11, 12, 44 i 48V DC. Pakowany w obudowie o wysokości modułu 1U BCM Array zajmuje powierzchnię 2cali². To rozwiązanie polepsza wydajność i redukuje ogólne koszty, jak również minimalizuje wielkość kondensatorów odprężających, gromadzących energię blisko obciążenia.

Moduł BCM Array łączy w sobie wysoką wydajność i gęstość mocy z lepiej dopracowanym odprowadzaniem ciepła, niższym natężeniem poziomu tworzonych szumów, szybką odpowiedzią na gwałtowne zmiany obciążenia i efektywnym projektem. Może być używany w wielu aplikacjach, włączając front-end PFC w serwerach. Obecnie trwa dystrybucja próbnych modułów wejściowych 384 V.

Zapraszamy do składania [zapytań](#) - przygotujemy satysfakcjonującą Państwa ofertę!



SE Spezial-Electronic Sp. z o.o.
ul. Stępińska 22/30 lok. 209 00-739 Warszawa
tel. 022 840 91 10 fax. 022 841 20 10

www.spezial.pl